

# 如何正确理解热导率

原创 Old\_Hao 集成电路封装设计 2025年12月1日 23:24

其实这篇文章是很早之前写的，当时写出来是为了给自己做个备份，担心时间久了自问时又得重新去扒它。赶巧上一篇讲热阻，这篇热导率也就丢出来献丑了！

转正文：

在我们封装工艺岗位，绝大多数人第一次接触散热相关知识，都是从热导率开始的。我们也都知道其本质是热导率越大，散热效果越好。关于热传导的问题在建立这个公众号之初就有详细介绍过，今天为什么把这个冷饭拿出来又炒一炒呢？因为近期在写体积电阻率的时候，对于其单位的理解挺费劲的，回头想想热导率也如出一辙，单位为  $\text{W}/(\text{C}^{\circ}\text{m})$ ，所以打算再拿出来扒一扒。

先看看百度百科这个晦涩难懂的解释：

热导率，又称“导热系数”。<sup>[1]</sup>是物质导热能力的量度。符号为λ或K。  
英文：coefficient of thermal conductivity  
是指当温度垂直向下梯度为 $1\text{C}/\text{m}$ 时，单位时间内通过单位水平截面积所传递的热量。  
其具体定义为：在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米，面积为1平方米的平行平面，若两个平面的温度相差 $1\text{K}$ ，则在1秒内从一个平面传导至另一个平面的热量就规定为该物质的热导率，其单位为 $\text{cal}/(\text{cm}\cdot\text{s}\cdot\text{C})$ 。  
公众号 - 集成电路封装设计

不知道你们看懂了没，反正这个描述我是看着挺糊涂的。相对而言《传热学》一书中的描述就人性化很多。

大量实践经验证明，单位时间内通过单位截面积所传导的热量，正比于当地垂直于截面方向上的温度变化率。即

$$\frac{\Phi}{A} \sim \frac{\partial t}{\partial x}$$

此处， $x$  是垂直于面积  $A$  的坐标轴。引入比例常数可得

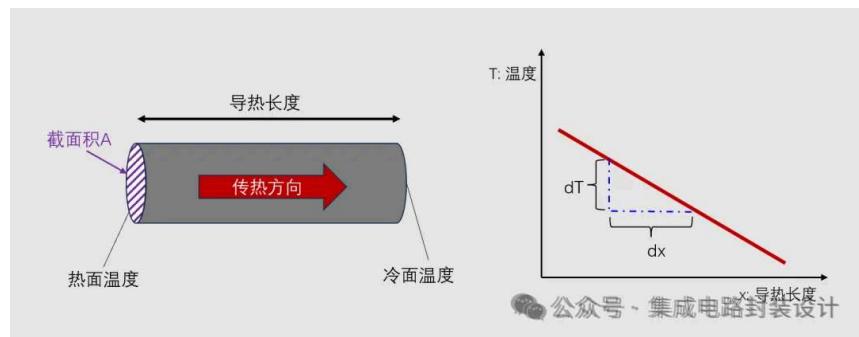
$$\Phi = -\lambda A \frac{\partial t}{\partial x}$$

公众号 - 集成电路封装设计 (2-3)

拆解下这句话。

1. 单位时间内通过单位截面积的热量：热量我们知道就是能量，单位是焦耳(J)，单位时间的能量，就是功率( $\text{W}=J/\text{s}$ )，因此这句话就可以解读为通过单位截面积的功率，即  $\Phi/A$ (文中将功率用  $\Phi$  来表示，面积用  $A$  表示)；

2. 垂直于截面方向的温度变化率：



热量在截面积相等，材质均匀的介质中沿截面垂直方向传播时，其温度随着传播传播长度线性变化，此时垂直于截面方向的温度变化率，即为右图直线的斜率，即  $dT/dx$ （原文温度用的小写“t”，为了避免与时间混淆，改为我们常用的大写T）；

3. 上文1和2成正比关系，并引入了比例系数λ：

$$\frac{\Phi}{A} = -\lambda \cdot \frac{dT}{dx} \quad \rightarrow \quad \Phi = -\lambda \cdot A \cdot \frac{dT}{dx}$$

公众号 · 集成电路封装设计

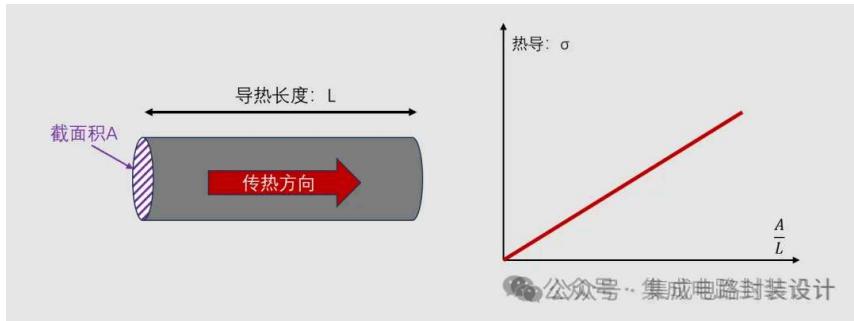
关于这个负号，个人理解是这样的：从上文可以看到，温度沿x方向走得越远，温度越低，因此 $dT$ 是个负数，为了确保我们所引入的比例系数 $\lambda$ 为正，因此等式中多加了一个负。而这个比例系数 $\lambda$ ，就是我们的热导率。

对等式进行变换，则可得到热导率的单位：

$$\lambda = -\frac{\Phi}{A} \cdot \frac{dx}{dT} \quad \text{带入量纲并抵消负号: } \lambda = \frac{W}{m^2} \cdot \frac{m}{^\circ C} = \frac{W}{^\circ C \cdot m}$$

公众号 · 集成电路封装设计

这是比较官方的理解，我个人更喜欢野路子的理解方式。野路子需要我们引入两个新的参量，分别是热阻( $R$ )和热导( $\sigma$ )。关于热阻我们大家都比较熟悉，表征材料阻碍热传导能力的参量，其单位是 $^\circ C/W$ ；而热导则是表征材料导热能力的参量，是热阻的倒数，单位便为 $W/^\circ C$ ；



野路子方面，我们就需要用到一些大家都了解的常识问题，即传热面积越大，散热越好；传热距离越大，散热越差；翻译过来就是，热导与传热面积成正比，与传热距离成反比：

$$\sigma \propto \frac{A}{L}$$

公众号 · 集成电路封装设计

当热传导面积 $A=0$ 时，材料的热导也就为0，因此该直线经过坐标轴0点。根据一元一次方程的通用关系式，过坐标0点的一元一次方程表达式为： $Y=a*X$ ；我们将热导 $\sigma$ 和传热面积、长度比 $A/L$ 带入式中，得到：

$$\sigma = a \cdot \frac{A}{L}$$

公众号 · 集成电路封装设计

式中 $a$ 为该直线的斜率，也就是我们讨论的热导率 $\lambda$ ；用 $\lambda$ 将 $a$ 替换掉并进行等式变换：

$$\sigma = \lambda \cdot \frac{A}{L} \quad \rightarrow \quad \lambda = \sigma \cdot \frac{L}{A} \quad \text{带入量纲: } \lambda = \frac{W}{^\circ C} \cdot \frac{m}{m^2} = \frac{W}{^\circ C \cdot m}$$

公众号 · 集成电路封装设计

又因为热阻( $R$ )和热导( $\sigma$ )互为倒数，则可轻松根据热导率( $\lambda$ )计算出传热面积不变的情况下均匀材料沿传热面垂直方向的热阻 $R$ ：

$$R = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{L}{A}$$

© 2018 电子工业出版社·集成电路封装设计

作者提示 个人观点，仅供参考